

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2019-006

紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刁石京	董事长	出差	马道杰

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2018年末总股本606,817,968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	紫光国微	股票代码	002049
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜林虎	董玉沾	
办公地址	河北省玉田县无终西街 3129 号	河北省玉田县无终西街 3129 号	
电话	0315-6198161	0315-6198181	
电子信箱	dulh@gosinoic.com	zhengquan@gosinoic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片，分别由紫光同芯微电子有限公司（简称“同芯微电子”）、深圳市国微电子有限公司（简称“国微电子”）和西安紫光国芯半导体有限公司（简称“西安紫光国芯”）三个核心子公司承担。石英晶体元器件业务由子公司唐山国芯晶源电子有限公司（简称“国芯晶源”）承担。未来，公司将继续积极布局半导体芯片产业领域，聚焦芯片设计业务，优化业务架构，持续推动公司战略目标的实现。

公司原控股子公司深圳市紫光同创电子有限公司主要从事可重构系统芯片的开发与销售，报告期内完成增资后，公司持股比例降低，成为公司参股子公司，自2018年8月起不再纳入公司合并报表范围。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,458,423,475.06	1,829,095,734.96	34.41%	1,418,572,250.23
归属于上市公司股东的净利润	347,973,762.41	279,887,242.88	24.33%	336,106,379.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,142,278.58	224,766,468.73	-13.18%	237,988,649.86
经营活动产生的现金流量净额	318,642,793.88	584,234,715.45	-45.46%	129,983,021.66
基本每股收益（元/股）	0.5734	0.4612	24.33%	0.5539
稀释每股收益（元/股）	0.5734	0.4612	24.33%	0.5539
加权平均净资产收益率	9.56%	8.39%	1.17 百分点	11.09%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	5,726,022,465.44	5,207,025,172.45	9.97%	4,466,612,123.14
归属于上市公司股东的净资产	3,794,380,450.30	3,494,639,839.91	8.58%	3,192,844,461.90

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	515,527,801.63	537,578,867.12	657,733,938.88	747,582,867.43
归属于上市公司股东的净利润	47,391,371.88	72,344,220.97	168,006,361.90	60,231,807.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,203,234.91	64,269,384.85	48,280,533.81	43,389,125.01
经营活动产生的现金流量净额	-90,449,944.15	6,369,793.66	-21,154,807.73	423,877,752.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

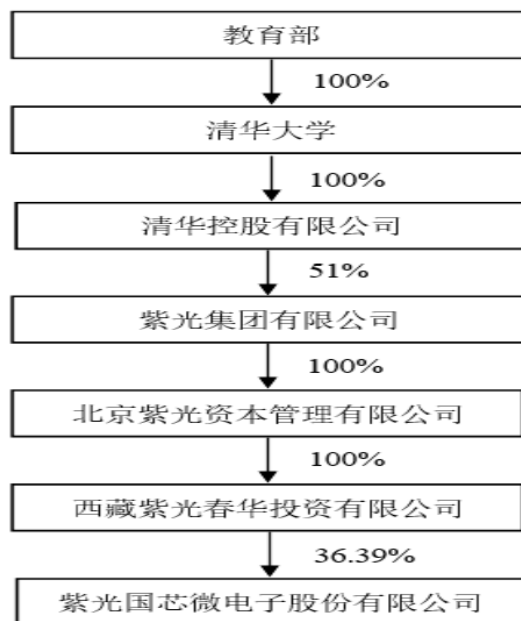
报告期末普通股股东总数	115,403	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	93,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏紫光春华投资有限公司	境内非国有法人	36.39%	220,835,000	0			
同方股份有限公司	国有法人	2.99%	18,147,368	0			
韩军	境内自然人	2.00%	12,131,818	0			
张士云	境内自然人	1.51%	9,150,000	0			

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	9,121,700	0		
阎永江	境内自然人	0.86%	5,238,320	0	质押	1,372,590
共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	5,230,940	0		
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	4,514,440	0		
王萍	境内自然人	0.60%	3,630,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	2,837,387	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏紫光春华投资有限公司的实际控制人清华控股有限公司为同方股份有限公司的控股股东。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，韩军通过普通证券账户持有公司 3,806,218 股股份，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,325,600 股股份，实际合计持有公司 12,131,818 股股份。王萍通过普通证券账户持有公司 0 股股份，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,630,000 股股份，实际合计持有公司 3,630,000 股股份。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



公司最终实际控制人为教育部。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18 国微 01	112708	2023 年 05 月 21 日	30,000	5.28%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)尚未到约定的付息日。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年5月，中诚信证券评估有限公司出具了《紫光国芯微电子股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体信用评级为AA+,评级展望稳定，本期债券的信用等级为AAA，该级别反映了本期债券信用质量极高，信用风险极低。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	33.62%	32.12%	1.50 百分点
EBITDA 全部债务比	84.00%	92.00%	-8.00 百分点
利息保障倍数	22.73	32.2	-29.41%

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

报告期内，在新兴产业需求的推动下，作为新一代信息技术的重要核心，我国集成电路产业继续保持快速发展，迎来重大发展机遇。但同时，外部竞争环境复杂多变，贸易保护主义升温、贸易摩擦加剧等风险因素也给产业发展带来很多不确定性。公司在董事会的领导下，聚焦“安全芯片”领域，发扬“二次创业”精神，梳理公司发展战略，凝聚企业发展共识，持续加大产品研发及市场开拓，多方位构筑竞争优势，推动核心业务规模和市场地位迈上新台阶，企业价值实现了稳步提升。

2018年度，公司实现营业收入245,842.35万元，较上年同期增加34.41%；归属于上市公司股东的净利润34,797.38万元，较上年同期增长了24.33%。截至2018年12月31日，公司总资产572,602.25万元，同比增长9.97%；归属于上市公司股东的所有者权益379,438.04万元，同比增长8.58%。其中，集成电路业务实现营业收入229,698.98万元，占公司营业收入的93.43%，晶体业务实现营业收入15,680.63万元，占公司营业收入的6.38%。

主营业务分析

报告期内，公司集成电路业务继续保持健康的发展态势，随着新产品、新业务的不断推出，综合竞争力明显提高，业务规模快速增长，行业地位进一步增强。在业务规模增长及产品结构变化对综合毛利率的不利影响下，仍然实现了收益的稳定增长。晶体业务行业供需关系转差，竞争加剧，销售收入与去年同期基本持平，贡献了稳定的毛利。

公司各主要业务的具体发展情况如下：

集成电路业务：**1. 智能安全芯片业务**

2018年度，公司的智能安全芯片产品市场表现强劲，产品销售额继续保持快速增长，营业收入达到

10.36亿元，规模化经营能力不断提高。报告期内，多款先进工艺的产品实现量产，综合竞争实力进一步增强。此外，公司在安全芯片的射频技术、安全算法和防攻击技术上有进一步的提升。

（1）智能卡安全芯片

2018年，公司电信SIM卡芯片顺利完成新工艺升级，推出多款基于先进工艺平台的新产品，为保持市场竞争优势提供了保障。受益于拉美和非洲市场4G迁移换卡和物联网安全芯片需求激增的拉动，全球SIM卡市场稳中有升，其中，中低端卡市场竞争仍非常激烈，高端卡市场存在上升空间。公司凭借丰富的产品线进一步打开新客户资源，中低端市场稳定出货，高端卡产品海外出货大幅增长，继续保持着领先的市场地位。此外，公司凭借产业链整合能力与品牌优势，在物联网安全芯片领域重点发力，获中移物联网招标大单，成功取得市场先机。通信类产品中物联网应用的比重快速攀升，正成为公司未来市场的有力增长点。

身份识别安全产品包括第二代居民身份证芯片、交通卡芯片和居住证芯片等。2018年，公司身份识别安全产品稳定出货。其中，第二代居民身份证芯片供货平稳增长；交通部标准的交通卡芯片首批获得测试认证，已在全国多个地市实现批量销售，市场份额继续保持领先；居住证芯片产品持续出货。此外，电子证照等新应用市场推广取得突破，成为公司本年度在该领域的发展亮点。

金融支付安全产品包括银行IC卡芯片、居民健康卡芯片和社保卡芯片等。在银行IC卡芯片出货量快速增长的带动下，公司金融支付安全产品销量实现了跨越式增长。2018年，国产银行IC卡芯片开始全面替代进口芯片，进口芯片占比持续下降。公司新一代金融IC卡芯片采用更先进的工艺技术，具有更优异的性能，并获得了国际SOGIS CC EAL5+认证，凭借产品优势以及积极的市场推广，在六大国有银行全部入围，并在绝大多数商业银行实现了规模供货，出货量突飞猛进，占据国密银行卡芯片市场领先地位。同时，随着VISA和MasterCard进入中国，EMV卡有望成为银行芯片市场新的增长点。公司重拳布局EMV卡市场，积极拓展海外市场，并率先发放使用中国芯的EMV卡。此外，受到“两保合一”政策影响，居民健康卡市场不确定性增大，需求缩减。公司社保卡产品继续在多个省市项目中稳定出货，着力推进参与的第三代社保卡试点、示范工程已实现多个项目的落地实施，赢得市场先发优势。

（2）智能终端安全芯片

公司智能终端安全芯片产品包括USB-Key芯片、POS机安全芯片和非接触读写器芯片。2018年，USB-Key芯片整体市场规模略有减少，公司产品稳定出货。随着非接触卡、双界面卡的普及，金融POS、支付终端产品、ETC及非接触式水电煤表等应用持续增加，对安全芯片与非接触读写器芯片需求保持增长势头。其中，传统POS安全模块市场稳健发展，公司保持领先优势，加速增长；在新型的mPOS主控芯片和非接触读写器芯片市场稳定增长。

2018年，公司大力拓展新兴业务，进军安全物联网、安全生物识别等领域，推出多款基于安全芯片的专业解决方案，与多家知名企业达成战略合作，联手推出手机安全U盾、汽车安全大脑等产品，为用户提供了安全放心的使用环境。同时，公司核心参与多项物联网领域标准制定，凭借不断坚持的产品与业务创新，有望迎来智能终端的下一个增长点。

2. 特种集成电路业务

公司特种集成电路业务主要产品包括：特种微处理器、特种可编程器件、特种存储器、特种总线及接口、特种电源电路、特种SoPC和定制芯片等几大类。2018年度，该业务各个领域都实现了高速增长，全年实现营业收入6.16亿元；大客户数量迅速增长，新产品应用不断扩大，业务进入高速发展阶段。

科研和产品开发工作方面，报告期内新产品开发项目持续推进，完成43款产品的鉴定，产品竞争力不断提高。公司的主流成熟产品已获得用户广泛认可，开始被大批量选用，进入了良性规模应用阶段。公司特种动态存储器产品、高性能及新一代FPGA产品、第二代SoPC平台产品都已经开始逐步进入批量应用阶段。新的SoPC产品也已经顺利完成开发，开始被用户选型使用。DC/DC电源产品已经被多个用户选型使用，后期将形成批量应用。

3. 存储器芯片业务

2018年度，DRAM存储器芯片市场需求先高后低，前三个季度持续高位景气，第四个季度开始急剧回

落。公司存储器业务2018年实现营收6.45亿元，同比增长超过93%。

公司的DRAM存储器芯片和内存模组已形成完整的产品系列，继续深耕国产计算机应用的市场，在服务器、个人计算机、机顶盒、电视机等方面出货稳步增加，进一步强化了国产DRAM存储器供应商的领导地位。目前，公司自主创新的内嵌ECC DRAM存储器产品在工控、电力、安防、通讯和汽车电子等领域销售稳定；公司开发的DDR4及LPDDR4等产品已经完成验证，正在客户送样；进行新一代GDDR6 物理接口的开发，并积极布局新一代低功耗、高带宽的存储器方案。平面SLC Nand Flash产品已经完成试样，实现小批量销售。

另外，基于先进技术的集成电路集成和验证服务业务的需求继续扩大。公司利用现有技术积累和人才团队的优势，进一步开发了集团内部产业链相关客户，同时积极拓展新的业务模式并取得初步进展，整个业务发展迅速。

4. 半导体功率器件业务

公司半导体功率器件业务专注于先进半导体功率器件的研发和销售，产品涵盖500V-1200V高压超结MOSFET、20V-150V中低压SGT/TRENCH MOSFET、40V-1200V VDMOS、IGBT、IGTO、SIC等先进半导体功率器件，产品广泛应用于节能、绿色照明、风力发电、智能电网、混合动力/电动汽车、仪器仪表、消费电子等领域，已形成领先的竞争态势和市场地位。

报告期内，高压超结MOSFET、中低压MOSFET产品的开发取得了明显的进展，形成了种类齐全、市场适用的产品系列，为未来的快速发展打下了良好的基础。

5. 可重构系统芯片业务

报告期内，可编程系统芯片（FPGA）业务全面开拓通信和工控市场，积极推进Titan系列高性能FPGA和Logos系列高性价比FPGA芯片的应用及产业化工作，已开始实现生产销售。Compact系列CPLD新产品已于2018年推向通信等市场，并已顺利导入部分客户项目。基于28nm工艺的新一代高性能FPGA研发进展顺利，已完成功能模块研发，争取尽快推向市场。

晶体业务：

公司晶体业务的主要产品包括石英晶体元器件。报告期内，受国内压电晶体行业扩张产能释放的影响，SMD3225产品出现供过于求，竞争加剧，产品价格下滑。另外，国际贸易摩擦也对石英晶体产品的出口产生不利影响。本年度共销售晶体元器件2.8亿件，较去年同期有所减少。市场仍以欧美等地区客户为主，出口占比近70%，实现销售收入1.57亿元，毛利保持稳定，但受蓝宝石生产线计提资产减值影响，最终实现净利润-2362万元。

报告期内，公司加大自动驾驶用压控频率模块（FCXO）、5G通讯用OCXO1409高稳产品、5G终端用VCXO3225等新产品的开发，积极开拓5G移动通讯、车用电子、工业控制、智能电表等新市场领域，加强集团内部合作（协作）及外部OEM合作，推动业务的健康发展。此外，公司积极推进信息化管理系统、完善工艺流程和ERP系统，在产品质量控制、生产成本管理方面都有新的进步。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能安全芯片	1,036,265,184.19	254,889,988.99	24.60%	27.41%	10.73%	-3.70%
特种集成电路	615,670,617.60	409,225,609.94	66.47%	19.29%	26.89%	3.98%

存储器芯片	645,053,969.00	49,143,310.43	7.62%	92.71%	106.87%	0.52%
晶体元器件	156,806,329.10	24,499,946.11	15.62%	-2.83%	-9.02%	-1.07%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对于执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1的要求编制2018年度及以后期间的财务报表。由于上述通知的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。	经董事会审议通过	参见其他说明

其他说明：

(1) 该项会计政策变更采用追溯调整法，公司可比年度报表已重新表述。

项目	2017年12月31日 /2017年度 合并	2017年12月31日 /2017年度 合并（经重述）	2017年12月31日 /2017年度 母公司	2017年12月31日 /2017年度 母公司（经重述）
应收票据及应收账款		1,087,681,973.74		2,723,595.84
应收票据	270,659,536.15		519,633.89	
应收账款	817,022,437.59		2,203,961.95	
应付票据及应付账款		487,132,289.24		7,000,000.00
应付票据	247,907,129.27			
应付账款	239,225,159.97		7,000,000.00	
其他应付款	4,353,944.43	4,624,234.53	692,147.29	692,147.29
应付利息	270,290.10			
管理费用	239,100,688.20	156,268,875.84	11,391,666.91	11,391,666.91
研发费用		82,831,812.36		
财务费用	28,717,653.05	28,717,653.05	4,085,047.23	4,085,047.23
利息费用		10,133,891.03		
利息收入		6,429,058.65		1,462,880.26
长期应付款		800,000.00		
专项应付款	800,000.00			

(2) 本次会计政策变更仅对公司财务报表列报产生影响，对公司净利润、净资产均无影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2018年7月26日，西藏紫光新材信息技术有限公司（以下简称“紫光新材”）和深圳市岭南聚仁股权投资合伙企业（以下简称“聚仁投资”）以现金向紫光同创增资2.51亿元，紫光同创注册资本由1.5亿元增加至3.0亿元，并于2018年8月6日完成工商变更登记。至此，紫光新材、茂业创芯持股比例均为36.5%，聚仁投资持股比例为27%，鉴于紫光新材在紫光同创董事会中拥有多数表决权，紫光同创及其全资子公司北京晶智意达科技有限公司和盘古设计系统有限公司自2018年8月起不再纳入本公司的合并报表范围。

2018年10月，本公司之全资子公司国微电子转让其全资子公司成都国微电子有限公司100%股权，股权转让后成都国微电子不再纳入公司的合并报表范围。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

紫光国芯微电子股份有限公司

董事长：刁石京

2019 年 4 月 11 日